



2026年3月期 第2四半期 (中間期) 決算短信 (日本基準) (連結)

2025年11月7日

上場会社名 TOWA株式会社

上場取引所 東

コード番号 6315 URL <https://www.towajapan.co.jp>

代表者 (役職名) 取締役社長執行役員 (氏名) 三浦 宗男

問合せ先責任者 (役職名) 取締役執行役員経営企画本部長 (氏名) 中西 和彦

TEL 075 - 692 - 0251

半期報告書提出予定日 2025年11月10日

配当支払開始予定日 —

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 有 機関投資家・アナリスト向け

(百万円未満切捨て)

1. 2026年3月期第2四半期 (中間期) の連結業績 (2025年4月1日～2025年9月30日)

(1) 連結経営成績 (累計)

(%表示は、対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 中間純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2026年3月期中間期	23,449	△14.4	2,493	△52.6	2,394	△54.2	1,849	△51.7
2025年3月期中間期	27,398	28.8	5,261	120.3	5,229	89.2	3,826	95.3

(注) 包括利益 2026年3月期中間期 3,912百万円 (162.6%) 2025年3月期中間期 1,489百万円 (△62.7%)

	1株当たり中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり中間純利益
	円 銭	円 銭
2026年3月期中間期	24.66	—
2025年3月期中間期	51.02	—

(注) 当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、「1株当たり中間純利益」を算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2026年3月期中間期	91,013	63,832	70.1
2025年3月期	83,228	61,386	73.8

(参考) 自己資本 2026年3月期中間期 63,832百万円 2025年3月期 61,386百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2025年3月期	—	0.00	—	20.00	20.00
2026年3月期	—	0.00			
2026年3月期 (予想)			—	20.00	20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2026年3月期の連結業績予想 (2025年4月1日～2026年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	円 銭
通期	56,000	4.7	9,800	10.4	9,800	4.3	6,860	△15.5

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

- (1) 当中間期における連結範囲の重要な変更 : 無
- (2) 中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 - ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数 (普通株式)

① 期末発行済株式数 (自己株式を含む)	2026年3月期中間期	75,157,367 株	2025年3月期	75,140,556 株
② 期末自己株式数	2026年3月期中間期	130,743 株	2025年3月期	134,055 株
③ 期中平均株式数 (中間期)	2026年3月期中間期	75,013,101 株	2025年3月期中間期	74,999,389 株

(注) 1. 当社は、2024年10月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数 (普通株式) を算定しております。

2. 期末自己株式数には、「株式給付信託 (J - ESOP)」制度の信託財産として株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) が保有する当社株式が含まれております。また、「株式給付信託 (J - ESOP)」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

※ 第2四半期 (中間期) 決算短信は公認会計士又は監査法人のレビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 1. 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想等に関する詳細は、添付資料P. 3「1. 経営成績等の概況 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
- 2. 当社は、2025年11月10日に機関投資家・アナリスト向け決算説明会 (会場及びウェブ) を開催する予定です。決算説明会資料及び決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況	2
(1) 当中間期の経営成績の概況	2
(2) 当中間期の財政状態の概況	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 中間連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 中間連結貸借対照表	4
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書	6
中間連結損益計算書	6
中間連結包括利益計算書	7
(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(連結の範囲または持分法適用の範囲の変更に関する注記)	8
(セグメント情報等の注記)	8

1. 経営成績等の概況

（1）当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間における世界経済は、米国の関税政策による不透明感が続いたものの、各国の政策支援や一部地域における内需の堅調さに支えられ、底堅く推移しました。

半導体業界においては、EV市場の成長鈍化による自動車向け需要の低迷や、レガシー半導体の回復の遅れなど、一部では停滞感が残る状況です。一方で、生成AIやデータセンター向けの需要が市場を牽引しており、高性能・低消費電力の半導体技術への投資が加速する中、業界全体としては堅調な成長を維持しています。

このような事業環境のもと、当社グループの当中間連結会計期間における業績は、民生品向け及びメモリ半導体の需要低迷に加え、米国の関税政策の影響により、前年度後半から受注が低迷したことで、第1四半期において売上高の落ち込みが大きく、前年同期比で減収減益となりました。

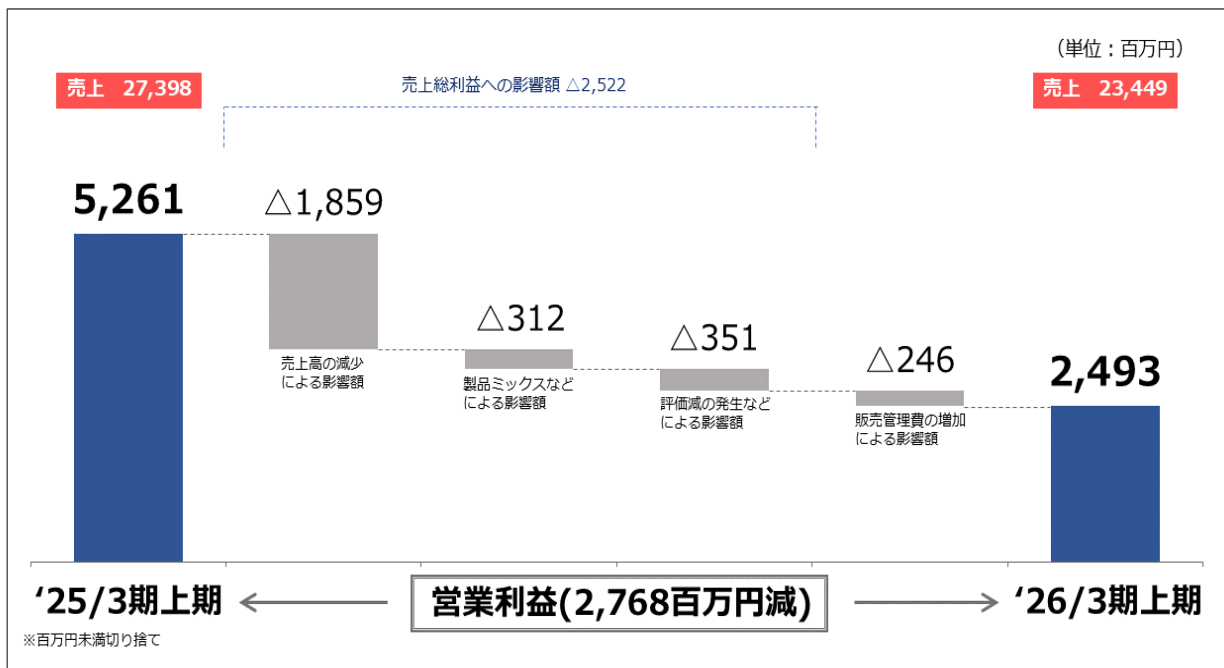
一方、第2四半期においては、中国、台湾、その他アジア地域を中心に半導体設備投資が徐々に回復しており、受注高及び売上高は増加基調となりました。各段階利益につきましても、当社独自のコンプレッション装置及び金型の売上比率が想定を上回ったことに加え、製品ミックスの改善などにより利益率が向上し、当初予想を上回る結果となりました。

当中間連結会計期間の経営成績は次のとおりであります。

売上高	234億49百万円（前年同期比39億48百万円、14.4%減）
営業利益	24億93百万円（前年同期比27億68百万円、52.6%減）
経常利益	23億94百万円（前年同期比28億35百万円、54.2%減）
親会社株主に帰属する中間純利益	18億49百万円（前年同期比19億76百万円、51.7%減）

当中間連結会計期間の営業利益の主な増減要因（対前年同期）は次のとおりであります。

売上高の減少による影響額	18億59百万円減
製品ミックスなどによる影響額	3億12百万円減
評価減の発生などによる影響額	3億51百万円減
販売管理費の増加による影響額	2億46百万円減



セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

[半導体製造装置事業]

半導体製造装置事業における経営成績は、前年度後半からのお客様による設備投資の様子見の影響により、中国、韓国、その他アジア地域を中心に売上が減少し、売上高は215億85百万円（前年同期比37億29百万円、14.7%減）となりました。利益につきましては、売上高の減少に伴い、営業利益23億50百万円（前年同期比27億12百万円、53.6%減）となりました。

[メディカルデバイス事業]

メディカルデバイス事業における経営成績は、医療用の組立品の需要が好調であったことから、売上高12億24百万円（前年同期比95百万円、8.4%増）となりました。利益につきましては、人件費等の増加により営業利益2億25百万円（前年同期比15百万円、6.3%減）となりました。

[レーザ加工装置事業]

レーザ加工装置事業における経営成績は、主力製品であるレーザトリマ装置に対するお客様の設備投資が引き続き見送られていることなどの影響により、売上高は6億40百万円（前年同期比3億14百万円、33.0%減）、営業損失82百万円（前年同期は営業損失41百万円）となりました。

(2) 当中間期の財政状態の概況

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ77億84百万円増加し910億13百万円となりました。これは、現金及び預金、棚卸資産等の流動資産及び固定資産が増加したことによるものです。

負債総額は、借入金等の増加により、前連結会計年度末に比べ、53億38百万円増加し271億80百万円となりました。

純資産は、為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ24億46百万円増加し638億32百万円となりました。

その結果、当中間連結会計期間末における自己資本比率は70.1%（前連結会計年度末比3.7ポイント減少）となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当中間連結会計期間における業績は、本日（2025年11月7日）公表の「2026年3月期第2四半期（中間期）連結業績予想値と実績値との差異に関するお知らせ」に記載のとおり、売上高は概ね予想通りの水準となりました。一方、各段階利益につきましては、高付加価値製品の売上比率が上昇したことで利益率が改善し、当初予想を上回る結果となりました。

なお、顧客の投資動向や市況の変化など、依然として不透明な要素が多く残されていることから、連結業績予想につきましては、2025年5月9日に公表いたしました「2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」に記載の通期連結業績予想から変更はございません。

2. 中間連結財務諸表及び主な注記

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	21,338,921	24,525,716
受取手形及び売掛金	11,391,221	12,777,955
電子記録債権	351,247	152,840
リース債権及びリース投資資産	19,965	16,196
商品及び製品	3,828,829	4,896,399
仕掛品	10,223,352	10,795,976
原材料及び貯蔵品	1,795,319	1,816,555
その他	1,709,806	1,238,862
貸倒引当金	△6,364	△5,391
流動資産合計	50,652,299	56,215,111
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	22,949,252	23,911,774
減価償却累計額	△13,670,130	△14,103,321
建物及び構築物 (純額)	9,279,121	9,808,453
機械装置及び運搬具	18,094,025	19,163,004
減価償却累計額	△12,434,302	△13,080,195
機械装置及び運搬具 (純額)	5,659,723	6,082,808
土地	6,566,490	6,669,469
リース資産	1,685,684	1,760,507
減価償却累計額	△509,906	△578,035
リース資産 (純額)	1,175,777	1,182,472
建設仮勘定	829,705	300,109
その他	5,248,194	5,533,676
減価償却累計額	△4,258,128	△4,501,541
その他 (純額)	990,066	1,032,135
有形固定資産合計	24,500,885	25,075,448
無形固定資産	1,421,284	1,530,019
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	678,782	709,421
その他	5,975,234	7,483,467
投資その他の資産合計	6,654,017	8,192,888
固定資産合計	32,576,186	34,798,356
資産合計	83,228,486	91,013,467

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当中間連結会計期間 (2025年9月30日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,551,525	3,559,358
電子記録債務	28,887	40,169
短期借入金	7,000,000	12,000,000
1年内返済予定の長期借入金	1,120,000	1,120,000
未払法人税等	1,222,764	651,493
製品保証引当金	313,722	308,101
賞与引当金	1,168,008	1,328,600
役員賞与引当金	117,231	40,134
その他	4,487,804	4,487,565
流動負債合計	18,009,944	23,535,424
固定負債		
長期借入金	1,370,000	810,000
退職給付に係る負債	1,014,238	1,032,000
株式給付引当金	82,967	112,500
その他	1,364,968	1,690,793
固定負債合計	3,832,173	3,645,294
負債合計	21,842,118	27,180,718
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,969,261	8,985,585
資本剰余金	464,571	480,895
利益剰余金	45,479,594	45,827,487
自己株式	△115,241	△111,954
株主資本合計	54,798,186	55,182,013
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,817,381	3,751,743
為替換算調整勘定	3,716,815	4,865,396
退職給付に係る調整累計額	53,984	33,595
その他の包括利益累計額合計	6,588,181	8,650,735
純資産合計	61,386,368	63,832,749
負債純資産合計	83,228,486	91,013,467

(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
(中間連結損益計算書)

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年9月30日)
売上高	27,398,749	23,449,896
売上原価	16,928,363	15,501,756
売上総利益	10,470,385	7,948,140
販売費及び一般管理費	5,208,686	5,454,562
営業利益	5,261,699	2,493,577
営業外収益		
受取利息	70,270	76,220
受取配当金	61,662	70,115
雑収入	228,060	158,959
営業外収益合計	359,993	305,295
営業外費用		
支払利息	41,071	62,563
為替差損	316,512	311,134
雑損失	34,911	31,069
営業外費用合計	392,495	404,767
経常利益	5,229,198	2,394,105
特別利益		
固定資産売却益	-	458
受取損害賠償金	-	87,588
特別利益合計	-	88,047
特別損失		
固定資産売却損	182	2,210
固定資産除却損	7,409	1,121
投資有価証券評価損	12,056	-
特別損失合計	19,648	3,332
税金等調整前中間純利益	5,209,549	2,478,820
法人税等	1,383,233	628,982
中間純利益	3,826,316	1,849,838
親会社株主に帰属する中間純利益	3,826,316	1,849,838

(中間連結包括利益計算書)

(単位：千円)

	前中間連結会計期間 (自 2024年 4 月 1 日 至 2024年 9 月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年 4 月 1 日 至 2025年 9 月30日)
中間純利益	3,826,316	1,849,838
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△2,196,807	934,361
為替換算調整勘定	△112,163	1,148,581
退職給付に係る調整額	△27,406	△20,388
その他の包括利益合計	△2,336,377	2,062,554
中間包括利益	1,489,938	3,912,392
(内訳)		
親会社株主に係る中間包括利益	1,489,938	3,912,392

(3) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(連結の範囲または持分法適用の範囲の変更に関する注記)

当中間連結会計期間において、TOWA MALAYSIA SALES & SERVICES SDN. BHD.、TOWA SEMICONDUCTOR INDIA PRIVATE LIMITED、和創半導体設備（深圳）有限公司を新たに設立したことに伴い、連結の範囲に含めております。

(セグメント情報等の注記)

【セグメント情報】

I 前中間連結会計期間（自2024年4月1日 至2024年9月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	25,314,874	1,129,068	954,807	27,398,749
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	25,314,874	1,129,068	954,807	27,398,749
セグメント利益又は損失(△)	5,063,208	240,059	△41,568	5,261,699

(注) セグメント利益又は損失の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。

II 当中間連結会計期間（自2025年4月1日 至2025年9月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

	半導体製造装置事業	メディカルデバイス事業	レーザ加工装置事業	計
売上高				
(1)外部顧客への売上高	21,585,649	1,224,106	640,139	23,449,896
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—	—
計	21,585,649	1,224,106	640,139	23,449,896
セグメント利益又は損失(△)	2,350,817	225,010	△82,249	2,493,577

(注) セグメント利益又は損失の合計額は、中間連結損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

各セグメントにおいて、重要な固定資産の減損損失及びのれんの金額の変動はありません。